## WHAT IS CLAIMED IS:

## 1. 電子カメラ:

被写体像を結像するための撮影レンズと、

結像された被写体像を光電変換するための撮像素子と、

前記撮影レンズから入射される被写体からの入射光を、前記撮像素子への第1 の光路と、前記第1の光路と異なる第2の光路と、へ案内するための光案内デバ イスと、

前記儀像素子及び前記光業内デバイスを包囲する保持枠構造と、前記保持枠構造は、熱伝導性材料からなり且つ前記振像素子に密着する密着部材を具備することと、

前記撮影レンズを内蔵するレンズ筺体と、前記レンズ筺体はカメラ外部に放熱 するための熱伝導性材料からなる放熱部を具備することと、

ここで、前記保持棒構造及び前記レンズ筐体は、前記密着部材からの熱が前記 放熱部に伝導されるように配設されることと、

# を具備する。

- 2. 請求項1に記載のカメラ:前配保持枠構造は、板状部材からなる前記密着 部材と、熱伝導性材料からなり且つ前記光案内デバイスを包囲すると共に前記密 着部材に熱的に接続される箱状の伝熱枠体とを具備し、前記放熱部は前記伝熱枠 体に熱的に接続される。
- 3. 請求項2に記載のカメラ: 前記板状部材は前記光案内デバイスに対面する 第1の面と、前記第1の面の反対側に位置する第2の面とを具備し、前記第1の 面上に前記撥像素子が密着し、前記第2の面上に回路基板が密着する。
- 4. 請求項3に記載のカメラ:前記撮像素子は前記回路基板に電気的に接続される。
- 5. 請求項1に記載のカメラ:前配光案内デバイスは、前記入射光を、第1及 び第2の光路へ分割するための光分割デバイスを具備する。
- 6. 請求項5に記載のカメラ:前記光分割デバイスは、ビームスプリッタ及びハーフミラーからなる群から選択された部材を具備する。
  - 7. 請求項1に記載のカメラ:前記光案内デバイスは、前記入射光を第1及び

第2の光路へ夫々出射させる第1及び第2の状態を切替えるための光路切替えデ バイスを具備する。

8. 請求項7に記載のカメラ:前記光路切替えデバイスは可動ミラーを具備する。

#### 9. 電子カメラ:

被写体像を結像するための撮影レンズと、

結像された被写体像を光電変換するための撮像素子と、

前記撮影レンズから入射される被写体からの入射光を、前記撮像素子への第1 の光路と、前記第1の光路と異なる第2の光路と、へ案内するための光案内デバ イスと、

前記操像素子及び前記光案内デバイスを包囲する保持枠構造と、前記保持枠構造は、熱伝導性材料からなり且つ前記操像素子に密着する密着部材を具備することと、

前記操像素子、前記光案内デパイス、及び前記保持枠構造を内蔵する外装筐体 と、前記外装筐体はカメラ外部に放熱するための熱伝導性材料からなる放熱部を 具備することと、

前記撮影レンズを内蔵するレンズ筐体と、前記レンズ筐体はカメラ外部に放熟 するための熱伝導性材料からなる放熱部を具備することと、

ここで、前記保持枠構造、前記外装筐体及び前記レンズ筐体は、前記密着部材からの熱が前記両放熱部に伝導されるように配設されることと、

# を具備する。

- 10. 請求項9に記載のカメラ: 前記保持枠構造は、板状部材からなる前記密 着部材と、熱伝導性材料からなり且つ前記光案内デバイスを包囲すると共に前記 密着部材に熱的に接続される箱状の伝熱枠体とを具備し、前記両放熱部は前記伝 熱枠体に熱的に接続される。
- 11. 請求項10に配載のカメラ:前記板状部材は前記光案内デバイスに対面 する第1の面と、前記第1の面の反対側に位置する第2の面とを具備し、前記第 1の面上に前記機像素子が密着し、前配第2の面上に回路基板が密着する。
  - 12. 請求項11に記載のカメラ:前記撮像素子は前記回路基板に電気的に接

続される。

- 13. 請求項9に記載のカメラ:前記光案内デバイスは、前記入射光を、第1 及び第2の光路へ分割するための光分割デバイスを具備する。
- 14. 請求項13に記載のカメラ:前記光分割デバイスは、ビームスブリッタ 及びハーフミラーからなる群から選択された部材を具備する。
- 15. 請求項9に記載のカメラ:前記光案内デバイスは、前記入射光を第1及 び第2の光路へ夫々出射させる第1及び第2の状態を切替えるための光路切替え デバイスを具備する。
- 16. 請求項15に記載のカメラ:前記光路切替えデバイスは可動ミラーを具備する。

#### 17. 電子カメラ・

被写体像を結像するための撮影レンズと、

結像された被写体像を光電変換するための撮像素子と、

前記撮影レンズから入射される被写体からの入射光を、前記機像素子への第1 の光路と、前記第1の光路と異なる第2の光路と、へ案内するための光案内デバ イスと、

前記機像素子及び前記光案内デバイスを包囲する保持枠構造と、前記保持枠構造は、熱伝導性材料からなり且つ前記撮像素子に密着する板状部材からなる密着 節材と、熱伝導性材料からなり且つ前記光案内デバイスを包囲すると共に前記密 着部材に熱的に接続される箱状の伝熱枠体とを具備することと、

前記操像素子、前記光業内デバイス、及び前記保持枠構造を内蔵する外装筐体 と、前記外装筐体はカメラ外部に放熱するための熱伝導性材料からなる放熱部を 具備することと、

ここで、前記保持枠構造及び前記外装筐体は、前記放熱部が前記伝熱枠体に熟 的に接続され、前記密着部材からの熱が前記放熱部に伝導されるように配設され ることと、

#### を具備する。

18. 請求項17に記載のカメラ: 前記板状部材は前記光案内デバイスに対面 する第1の面と、前記第1の面の反対側に位置する第2の面とを具備し、前記第

- 1の面上に前記撮像素子が密着し、前記第2の面上に回路基板が密着する。
- 19. 請求項18に記載のカメラ: 前記撮像素子は前記回路基板に電気的に接続される。
- 20. 請求項17に記載のカメラ:前記光案内デバイスは、前記入射光を、第 1及び第2の光路へ分割するための光分割デバイスを具備する。
- 21. 請求項17に記載のカメラ: 前記光案内デバイスは、前記入射光を第1 及び第2の光路へ夫々出射させる第1及び第2の状態を切替えるための光路切替 えデバイスを具備する。